

TMサイナスリフトキット MK-II

歯科用インプラント手術器具

ソケットリフトに使用する上顎洞底粘膜剥離用と骨補填材填塞用の
専用インスツルメントです。



Features

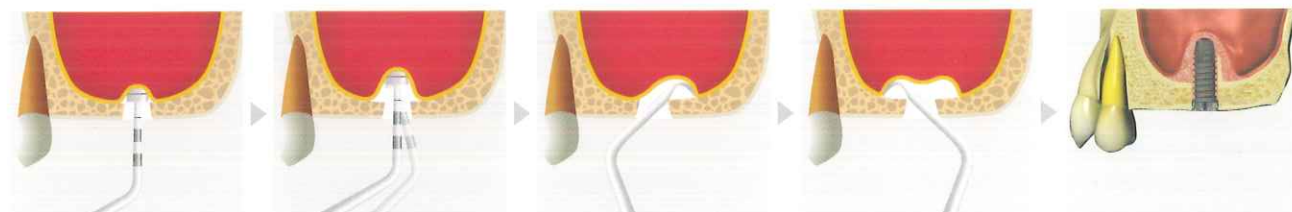
経歯槽頂上顎洞粘膜挙上術(ソケットリフト)に使用する専用の上顎洞粘膜剥離用と骨補填材填塞用のインストルメントです。

- TMサイナスリフトキット MK-II のラインネック#2・#3の両端はそれぞれ45°と90°の角度が付与され頬側・口蓋側・近心・遠心の洞底部の粘膜の剥離に便利です。
- ヘッド部に目盛りが付与されているため、挙上しながら距離の計測が行えます。また、従前のTMサイナスリフトキットに比べ、ヘッド部が長く洞粘膜をより深く剥離しやすくなっています。

TMサイナスリフトキット MK-II



使用手順



最初の洞粘膜の剥離は開洞後、グーズネック#1のヘッド部を用いて、頭部を洞底部に掛けて、骨に這わせつつ円を描くように周囲の洞粘膜を剥離します。インプラント窩の大きさに応じてφ2.8mmないしφ3.3mmのヘッド部を使用します。

最初の洞粘膜の開洞後、癒着がある場合は、垂直用剥離器具であるグーズネック#1のヘッド部を用いて、洞内で頭頂部をあらゆる方向に軽く突き上げながら「ヘッド部」を動かすと洞底粘膜はきれいに剥がれます。

2回目の剥離操作です。癒着が強い場合や剥離が不十分な時は、まずラインネック#3を用いて、先端を洞底部骨壁に沿わせながら洞底粘膜剥離を広げます。

次にラインネック#2に変更して同様に剥離操作を進めます。剥離が終了したら必ず各インストルメントに共通のヘッド部の目盛りで剥離深度を確認します。

洞底部と洞粘膜の隙間に過不足なく骨補填材を填塞された状態で、適法に従いインプラント体を埋入します。(垂直的挙上距離の高さは洞内に突出したインプラント体の長さ以上にする。)

剥離手順動画



Specifications

TMサイナスリフトキット MK-II #1	20,800円	2067800541
TMサイナスリフトキット MK-II #2	20,800円	2067800542
TMサイナスリフトキット MK-II #3	20,800円	2067800543
TMサイナスリフトキット MK-II 減価力セット	14,200円	206780055

販売名:TMサイナスリフトキット MK-II 一般名:歯科用インプラント手術器具 医療機器届出番号:13B1X10238MT0006
医療機器の分類:一般医療機器(クラスI) 製造販売:株式会社アルファメッド 製造:MCTBIO社



動画ご協力: 室木俊美先生 (DDS.,DMSc.,PhD) 〈石川県で開業〉

朝日大学歯学部卒業
金沢大学医学部大学院口腔顎顔面外科修了
日本口腔外科学会専門医、日本口腔インプラント学会指導医・専門医・代議員
日本口腔診断学会指導医
SPIアドバイザーメンバー
金沢大学医薬保健研究域医学系・協力研究員
金沢医科大学非常勤講師
石川臨床インプラント学術研究会 会長

●標準価格の後の9ケタの数字は品目コードです。●掲載商品の価格は2025年7月22日現在のもので、標準価格には消費税等は含まれておりません。●ご使用に際しましては、製品の添付文書及び使用方法を必ずお読みください。
●仕様及び外観は製品改良のため予告なく変更されることがありますのでご了承ください。●製品の色は印刷のため、実際とは異なる場合がございます。

販売 株式会社モリタ 大阪本社:大阪府吹田市垂水町3-33-18 〒564-8650 T 06.6380 2525 東京本社:東京都台東区上野2-11-15 〒110-8513 T 03.3834 6161

お問合せ: お客様相談センター 〈歯科医療従事者様専用〉 T 0800.222 8020 (フリーコール)

www.dental-plaza.com

PUB: NO.M8291.1.2506.50.700G.IO/JPC 208530648